



## 技术简讯

[ 1 / 2 ]

FA-CN-0314-A

### MELSEC iQ-R系列的包装盒变更的通知(2020年8月开始生产的产品)

#### ■出版年月

2020年8月

#### ■相关机型

RX41C4、RX42C4、RX71C4、RX72C4、RY41NT2P、RY42NT2P、RY41PT1P、RY42PT1P、RX41C6HS、RX61C6HS、RY41NT2H、RY41PT2H、RD75P2、RD75P4、RD75D4、RD62P2、RD62D2、RD62P2E、RD40PD01、R60AD8-G、R60DA8-G、R60RD8-G、RG60、R00CPU、R01CPU、R02CPU

感谢惠顾三菱电机可编程控制器。

特此通知MELSEC iQ-R系列的部分机型的包装盒的变更。此外，包装内的模块的功能、性能并无变更。

## 1 对象机型与包装盒的大小

对象机型		包装盒的大小	
品名	型号	变更前	变更后
DC输入模块	RX41C4	160 (W)×147 (D)×47 (H) [mm]	124 (W)×121 (D)×40 (H) [mm]
	RX42C4		
	RX71C4		
	RX72C4		
晶体管输出模块	RY41NT2P		
	RY42NT2P		
	RY41PT1P		
	RY42PT1P		
DC高速输入模块	RX41C6HS		
	RX61C6HS		
晶体管高速输出模块	RY41NT2H		
	RY41PT2H		
定位模块	RD75P2		
	RD75P4		
	RD75D4		
高速计数器模块	RD62P2		
	RD62D2		
	RD62P2E		
柔性高速I/O控制模块	RD40PD01		
通道间绝缘模-数转换模块	R60AD8-G		
通道间绝缘数-模转换模块	R60DA8-G		
通道间绝缘测温电阻输入模块	R60RD8-G		
空插槽盖板模块	RG60		
可编程控制器CPU	RO0CPU		
	R01CPU		
	R02CPU		

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE : TOKYO BUILDING, 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN  
NAGOYA WORKS : 1-14 , YADA-MINAMI 5-CHOME , HIGASHI-KU, NAGOYA , JAPAN

FA-CN-0314-A

变更后的外观及部件材料构成如下所示。

变更前	变更后
	
	

纸板盒1个(外包装盒)+纸浆模具2个(内包装材料)

纸板盒1个(外包装盒)

## 2 变更理由

作为节约资源活动(ISO 14001)的一环，为了通过将缓冲材料变更为纸板盒降低环境负荷。

## 3 变更时期

从2020年8月生产的产品开始依次替换。

但是，由于库存关系，在流通阶段可能会出现新旧包装盒并存的情况。

### 修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2020年8月	第一版